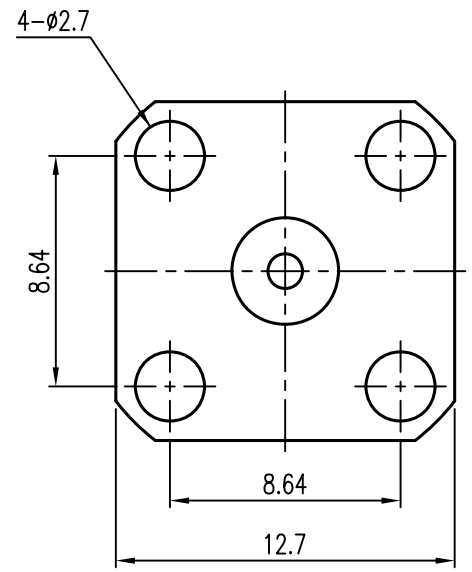
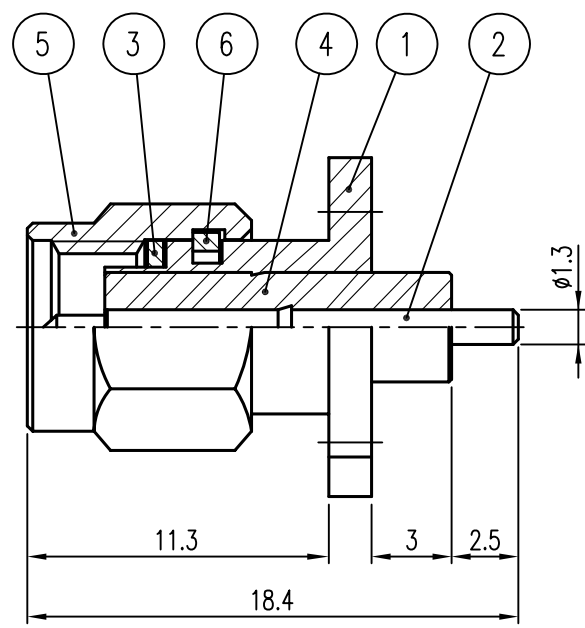


개정 ST											수 정 내 용				
											부호	내 용	수정자	승인자	년 월 일
ST(기준)											1	[첨변No.201806-0001] 조립성 개선으로 인한 배다 납시배는 추가	은선영	김인철	2018. 06. 04.
ST(개선)															



6	SPRING RING	1	SUS	부동태 처리	DSR00002-5/1
5	COUPLING CAP	1	MBsBD	Gold Plate	DCU00005-5/1
4	INSULATOR	1	TEFLON		DIN01129-N/1
3	GASKET	1	SILICONE RUB		DGK00004-N/1
2	CONTACT	1	MBsBD	Gold Plate	DCT01246-5/1
1	BODY	1	MBsBD	Gold Plate	DBD00358-5/1

대체가능재질	품번	품 명		수량	재 질	표면처리	비 고
공통공차 ±0.2	년월일	1997. 5. 8.		 RF & MICROWAVE TECHNOLOGY Tel : 82-02-347-8015 Fax : 82-02-347-8017 KJ COMTECH CO.,LTD.			
	승인						
재질	검도			도명	SMA50 SOLDER END PS-4H		
	제도						
열처리	작성부서		연 구 소		도번 CN01468-7/1 K314-491-001		
보호피막처리	적도 4/1	단위 mm	중량	A4			